

2020年中国晶圆加工市场前景研究报告- 产业现状与发展规划趋势

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国晶圆加工市场前景研究报告-产业现状与发展规划趋势》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/439936439936.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

晶圆代工（Foundry）是半导体产业链的基础，从工艺节点来看，各制程市场分别为16nm及以上工艺、16-28nm先进工艺、28-90nm成熟工艺、90nm以上的8寸及其他。晶圆代工有着高资本壁垒和技术壁垒，十多年来行业没有新的竞争者出现且越来越多现有厂商放弃先进制程追赶。预计2018~2023年晶圆代工市场复合增速为4.9%，其中2019年全球晶圆代工市场约627亿美元，占全球半导体市场约15%。

2017-2023年全球晶圆代工市场规模及预测

数据来源：gartner

目前，全球晶圆代工市场的三大区域分别为中国台湾、中国大陆、韩国，台湾占据较大份额，占比达66%左右，大陆处于追赶角色，在全球中的比重持续提升，预计将从2017年的9%提升至2023年的12.9%。

2017-2023年全球晶圆代工区域占比

数据来源：中国半导体工业协会

2019年中国大陆本土晶圆代工整体营收为391亿元人民币，同比下降0.6%。其中，本土七大晶圆代工公司仅有华虹集团和晶合集成增速呈正值，其他五家营收均呈现不同程度的下滑。数据来源：中国半导体工业协会（TC）【报告大纲】

第一章 晶圆加工行业发展概述

第一节 行业概述

一、行业定义

二、行业分类

第二节 晶圆加工所属行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒 / 退出机制

第二章 2017-2020年中国晶圆加工行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境分析

一、国际宏观经济运行分析

二、国内宏观经济运行分析

三、十三五国内经济形势预测

四、宏观经济对产业影响分析

第二节 晶圆加工行业政策环境分析

一、晶圆加工行业的管理体制

二、晶圆加工行业主要政策内容

三、产业政策风险

四、政策环境对行业的影响分析

第三节 晶圆加工行业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、中国城镇化率

六、社会环境对行业的影响分析

第四节 技术环境

一、主要生产技术分析

二、技术发展趋势分析

三、国际晶圆加工技术发展分析

四、国内外晶圆加工技术对比

第三章 2017-2020年世界晶圆加工所属产业运行态势透析

第一节 2017-2020年世界晶圆加工所属产业运行环境分析

一、世界晶圆加工发展历程

二、世界晶圆加工主要生产企

第二节 2017-2020年年世界晶圆加工市场剖析及对中国市场影响

一、世界晶圆加工市场发展概况

二、世界晶圆加工消费情况分析

三、世界晶圆加工价格走势分析

第三节 2017-2020年世界晶圆加工行业区域市场分析

一、美国

二、韩国

三、日本

四、亚洲其他地区

第四节 2021-2026年世界晶圆加工产业发展趋势分析

一、2021-2026年晶圆加工市场发展前景

二、2021-2026年晶圆加工供需状况分析

第四章 晶圆加工所属行业总体发展状况

第一节 中国晶圆加工所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国晶圆加工所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国晶圆加工所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第五章 2017-2020年中国晶圆加工产业链分析

第一节 晶圆加工行业上游行业分析

一、上游行业发展现状

二、上游行业发展趋势预测

三、上游行业对晶圆加工行业的影响

第二节 晶圆加工行业下游行业分析

一、下游行业发展现状

二、下游行业发展趋势预测

三、下游行业对晶圆加工行业的影响

第六章 晶圆加工行业区域市场分析

第一节 华东地区晶圆加工行业分析

一、地区半导体发展现状分析

二、晶圆加工生产状况分析

三、晶圆加工下游需求分析

四、行业发展前景预测

第二节 华北地区晶圆加工行业分析

一、地区半导体发展现状分析

二、晶圆加工生产状况分析

三、晶圆加工下游需求分析

四、行业发展前景预测

第三节 东北地区晶圆加工行业分析

- 一、东北地区半导体发展现状分析
- 二、晶圆加工生产状况分析
- 三、晶圆加工下游需求分析
- 四、行业发展前景预测

第四节 华中地区晶圆加工行业分析

- 一、地区半导体发展现状分析
- 二、晶圆加工生产状况分析
- 三、晶圆加工下游需求分析
- 四、行业发展前景预测

第五节 华南地区晶圆加工行业分析

- 一、地区半导体发展现状分析
- 二、晶圆加工生产状况分析
- 三、晶圆加工下游需求分析
- 四、行业发展前景预测

第六节 西部地区晶圆加工行业分析

- 一、地区半导体发展现状分析
- 二、晶圆加工生产状况分析
- 三、晶圆加工下游需求分析
- 四、行业发展前景预测

第七章 2017-2020年晶圆加工行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

- 一、晶圆加工行业竞争结构分析
- 二、晶圆加工行业集中度分析
- 三、晶圆加工行业SWOT分析

第二节 中国晶圆加工行业竞争格局综述

- 一、晶圆加工行业竞争概况
- 二、中国晶圆加工行业竞争力分析
- 三、晶圆加工行业主要企业竞争力分析

第三节 晶圆加工市场竞争格局总结

- 一、提高晶圆加工行业竞争力的有力措施
- 二、提高晶圆加工企业竞争力的几点建议
- 三、晶圆加工提高核心竞争力的建议

第八章 晶圆加工行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 台积电（TSMC）

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第二节 三星 (Samsung)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第三节 富士通 (Fujitsu)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第四节 GlobalFoundries

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第五节 中国台湾联华电子 (UMC)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第六节 中芯国际 (SMIC)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第七节 英特尔

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第八节 SK海力士

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第九节 紫光

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十节 长江存储

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第九章 2021-2026年晶圆加工行业前景及趋势预测

第一节 2021-2026年晶圆加工市场发展前景

一、2021-2026年晶圆加工市场发展潜力

二、2021-2026年晶圆加工市场发展前景展望

第二节 2021-2026年晶圆加工市场发展趋势预测

一、2021-2026年晶圆加工行业发展趋势

二、2021-2026年晶圆加工市场规模预测

第三节 2021-2026年中国晶圆加工行业供需预测

一、2021-2026年供给预测

二、2021-2026年下游需求预测

三、2021-2026年整体供需平衡预测

四、2021-2026年中国晶圆加工投资规模预测

第十章 2021-2026年晶圆加工行业投资机会与风险防范

第一节 晶圆加工行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、晶圆加工行业投资现状分析

第二节 晶圆加工行业投资机会分析

一、晶圆加工投资项目分析

二、可以投资的晶圆加工模式

第三节 2021-2026年中国晶圆加工行业发展预测分析

一、未来晶圆加工发展分析

二、未来晶圆加工行业技术开发方向

第四节 2021-2026年晶圆加工行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、关联产业风险及防范

五、其他风险及防范

第十一章 晶圆加工行业发展战略研究

第一节 晶圆加工行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国晶圆加工品牌的战略思考

一、晶圆加工品牌的重要性

二、晶圆加工实施品牌战略的意义

三、晶圆加工企业品牌的现状分析

四、我国晶圆加工企业的品牌战略

五、晶圆加工品牌战略管理的策略

六、国内外晶圆加工品牌对比及策略建议

第三节 晶圆加工经营策略分析

一、晶圆加工市场细分策略

二、晶圆加工市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、晶圆加工新产品差异化战略

第四节 晶圆加工行业投资战略研究

一、2021-2026年晶圆加工行业投资战略

二、2021-2026年细分行业投资战略

第十二章 研究结论及发展建议

第一节 晶圆加工行业研究结论及建议

第二节 晶圆加工子行业研究结论及建议

第三节 晶圆加工行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录：

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业毛利率

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业营业收入增长率

图表：我国宏观经济预测

图表：2020年全国人口数及其构成

图表：普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数

图表：2017-2020年中国R & D经费支出（亿元）及其增长速度

图表：2020年专利申请、授权和有效专利情况

图表：全球对12寸硅晶圆每月需求量

图表：2017-2020年中晶圆加工市场规模

图表：半导体产业微笑曲线

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业净利率

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业流动比率

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业资产负债率

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业总资产周转率

图表：2017-2020年中国晶圆加工行业存货周转天数

图表详见报告正文 (GYSYL)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国晶圆加工市场前景研究报告-产业现状与发展规划趋势》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面

了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/439936439936.html>